

X線透視観察における注意事項

要旨

半導体製品と基板の接続状態や半導体製品自体の解析など、X線を用いた透視観察（X線観察）は広く用いられています。X線観察は構造的な破壊を伴わずに、物体内部の観察が可能です。しかしながらX線の照射を受けることで、半導体製品の電気的特性が変動することがあります。この資料では故障解析において、半導体製品の電気的特性変動リスクに配慮しながらX線観察を行うためのポイントを解説します。

目次

1. X線照射による影響.....	2
2. 吸収線量.....	2
3. 推奨事項.....	2
お断り.....	3
改訂記録.....	4

1. X線照射による影響

X線観察は非常に有効な非破壊解析の手段であり、観察対象の内部観察を行う上で構造的な加工を必要としません。一方でX線はエネルギーを持つ電磁放射線であることから、照射された半導体製品にエネルギーを与えることで、その電氣的な状態を変えてしまうことがあります。

製造工程のX線検査は比較的短い照射時間で管理されていることが多く、照射された半導体製品の電氣的特性への影響が問題として現れることは通常ありません。一方で故障解析においては、観察方向や倍率を変えた繰り返し観察など詳細な解析を実行しようとするあまり、比較的長時間あるいは短時間であっても強いX線に半導体製品がさらされた結果、電氣的特性や不揮発性メモリのデータに変化が生じてしまうことがあります。これは物理的な現象であり、X線観察を実施する際にはその結果として起こり得るリスクを正しく認識することが重要です。

2. 吸収線量

物質がX線から受け取ったエネルギーは、吸収線量：Gy（グレイ）で表されます。小さな吸収線量では半導体製品の電氣的特性はX線照射前後で変動が見られない、または微小な変動にとどまります。しかしながら吸収線量が大きくなれば、製品ごとに規定される特性規格を超えた変動を起こしてしまうこともあります。個別にご案内のある製品を除き、対放射線設計をしていない一般の半導体製品では、吸収線量をおよそ1Gy以下に抑えることが期待されています。

3. 推奨事項

電氣的特性への影響を防ぎつつX線観察を行う際には、できるかぎり吸収線量を抑えることが重要です。以下にそのポイントを示します。なお、X線照射条件と取得できるX線像、および観察対象が受け取る吸収線量の関係は、ご使用の装置によって異なります。ご使用の装置を用いて評価し、その特性を把握することを推奨します。

3.1 X線出力

X線観察では管電圧と管電流で、X線管から出力させるX線の強度を調整します。X線の強度は管電圧の2乗に、管電流の1乗にそれぞれ比例して大きくなるため、小さな条件ほど吸収線量を抑えることができます。一方でこれらはX線像を決定するパラメータのため、適切な範囲から外れてしまうと十分な画質のX線像を得ることができません。必要な画質のX線像を得ることのできる範囲内で、できるかぎり小さな管電圧・管電流条件としてください。

3.2 観察倍率

X線観察では観察倍率を上げると、X線源と観察対象が接近します。X線の強度は距離の2乗に反比例して減衰します。このため観察対象が受ける吸収線量は倍率を上げるほど加速度的に増加するため、より低い倍率での観察を推奨します。特に半導体製品は小さな部品であり、全体像の観察でもある程度の倍率が要求されます。そのため吸収線量をできるだけ抑えるといった観点においては、必要以上に拡大しないことが望ましいといえます。

3.3 照射時間

X線を照射する時間が長いほど、観察対象の受ける吸収線量は増加します。繰り返し観察を行う場合は、各照射時間の累積となります。X線を照射する時間はできるだけ短くすることを推奨します。

3.4 X線フィルタ

X線フィルタは低エネルギー領域のX線を吸収する機能を持っています。X線源と観察対象の間に挿入することで、観察対象の吸収線量が軽減される効果が期待されます。

3.5 その他

半導体製品のX線観察を実施した後は、その電気的特性を確認することを推奨します。X線観察後に特性異常が発見された場合は、X線照射の影響が疑われます。

故障解析では倍率や視点を変えた繰り返し観察や、多方面からのX線照射により立体情報を得るX線CT (Computer Tomography) が行われることがあります。こうした解析では半導体製品が受ける吸収線量が大きく、電気的特性に影響が表れる場合があります。一方で、これらが構造的な不具合解析に対して有効な手段であることに間違いはありません。したがって解析目的と半導体製品の電気的特性への影響の双方をご検討された上で、実施のご判断をされることを推奨します。

お断り

1. 当社の一般向け半導体製品は対放射線設計をしておりません。したがって、製品個別のX線耐量へのお問い合わせにお答えすることはできません。またX線照射でその特性に問題が生じた製品の調査依頼についても、承ることはできません。
2. X線照射と製品の電気的特性への影響の関係は、ご使用のX線解析環境にも依存します。当社からご使用環境における推奨条件を提示することはできません。それぞれの環境で評価の上で、実施のご判断をお願いします。

X線透視観察における注意事項

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct 10, 2023	－	新版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。